

北一電気株 実装設備リスト

ライン構成		設備詳細				基本仕様※			小型部品対応能力可否					大型部品対応サイズ		N2対応の可否、設置鉛フリー			オプション	導入年月	備考	Pbフリー対応					
区分	ライン名	名称・型番	内容	メーカー	台数	ワークサイズ	装着タテ (sec)	搭載可能部品本数	1.6*0.8	1.0*0.5	0.6*0.3	0.4*0.2	0.3*0.15	0.2*0.1	縦横サイズ	高さ	可	否	設置済み								
SMT	SMT-1		基板クリーニング装置	ヒムエレクトロ	1	510*460																	16-12				
		SPG	クリーム半田印刷機	ハナソニック	1	510*460																		16-12	SPI連携		
		MS-11e	3Dはんだ印刷検査装置	ミルテック	1	510*460																		16-12	検査結果フィードバック機能搭載		
		NXT III c (OF)	チップマウンター	富士機械製造	1	534*380	0.84	45	○							74.0*74.0(32.0*180.0)	38.1							16-12	Nexim		
		NXT III c (H24G)	チップマウンター	富士機械製造	1	534*380	0.096	45	○	○	○	○	○	○	○	5.0*5.0	2.0							16-12	Nexim		
		NXT III c (V12)	チップマウンター	富士機械製造	2	534*380	0.14	45	○	○	○	○	○	○	○	7.5*7.5	3.0							16-12	Nexim		
		NXT III c (H08MQ)	チップマウンター	富士機械製造	1	534*380	0.28	45	○	○	○	○	○	○	○	45.0*45.0	13.0							16-12	Nexim		
		NXT III c (H02F)(LTC付)	チップマウンター	富士機械製造	2	534*380	0.54	19	○							74.0*74.0(32.0*180.0)	25.4							16-12	Nexim	トレ部品搭載	
		SNR-1050GT	リフロー	千住	1	500*500													○		済み		自動幅調/ソリ防止/他	16-12	KIC搭載	済み。実績あり	
		YSi-V	3D半田外観検査装置	ヤマハ	1	610*560					○	○	○						○		済み			18-10		済み。実績あり	
	SMT-2		基板クリーニング装置	ヒムエレクトロ	1	510*460																		16-12			
		SPG	クリーム半田印刷機	ハナソニック	1	510*460																		16-12	SPI連携		
		MS-11e	3Dはんだ印刷検査装置	ミルテック	1	510*460																		16-12	検査結果フィードバック機能搭載		
		YSM20-2(HM-FM)	チップマウンター	ヤマハ	1	810*490	0.04	128	○	○	○	○	○	○	○	45.0*100.0	15.0							16-12	ITオプション(フル仕様)		
		YSM20-2(HM-FM)(s-ATS付)	チップマウンター	ヤマハ	1	810*490	0.058	96	○	○	○	○	○	○	○	55.0*100.0	28.0							18-02	トレ部品搭載		
		YSM20-2(HM-FM)	チップマウンター	ヤマハ	1	810*490	0.058	128	○	○	○	○	○	○	○	55.0*100.0	28.0							16-12	ITオプション(フル仕様)		
		SNR-1050GT	リフロー	千住	1	500*500													○		済み		自動幅調/ソリ防止/他	16-12	KIC搭載	済み。実績あり	
		YSi-V	3D半田外観検査装置	ヤマハ	1	610*560					○	○	○						○		済み			18-02		済み。実績あり	
		SMT-3		基板クリーニング装置	ヒムエレクトロ	1	510*460																		16-12		
			SPG	クリーム半田印刷機	ハナソニック	1	510*460																		16-12	SPI連携	
	MS-11e		3Dはんだ印刷検査装置	ミルテック	1	510*460																		16-12	検査結果フィードバック機能搭載		
	YSM20-2(HM-FM)		チップマウンター	ヤマハ	1	810*490	0.04	128	○	○	○	○	○	○	○	45.0*100.0	15.0							16-12	ITオプション(フル仕様)		
	YSM20-2(HM-FM)(s-ATS付)		チップマウンター	ヤマハ	1	810*490	0.058	96	○	○	○	○	○	○	○	55.0*100.0	28.0							16-12	トレ部品搭載		
	YSM20-2(HM-FM)		チップマウンター	ヤマハ	1	810*490	0.058	128	○	○	○	○	○	○	○	55.0*100.0	28.0							16-12	ITオプション(フル仕様)		
	SNR-1050GT		リフロー	千住	1	500*500													○		済み		自動幅調/ソリ防止/他	16-12	KIC搭載	済み。実績あり	
	YSi-V		3D半田外観検査装置	ヤマハ	1	610*560					○	○	○						○		済み			17-10		済み。実績あり	
	SMT-4			基板クリーニング装置	ヒムエレクトロ	1	510*460																		16-12		
			SPG	クリーム半田印刷機	ハナソニック	1	510*460																		16-12	SPI連携	
		MS-11e	3Dはんだ印刷検査装置	ミルテック	1	510*460																		16-12	検査結果フィードバック機能搭載		
		NXT III c (OF)	チップマウンター	富士機械製造	1	534*380	0.84	45	○							74.0*74.0(32.0*180.0)	38.1							16-12	Nexim		
		NXT III c (H24G)	チップマウンター	富士機械製造	1	534*380	0.096	45	○	○	○	○	○	○	○	5.0*5.0	2.0							16-12	Nexim		
		NXT III c (V12)	チップマウンター	富士機械製造	2	534*380	0.14	45	○	○	○	○	○	○	○	7.5*7.5	3.0							16-12	Nexim		
		NXT III c (H08MQ)	チップマウンター	富士機械製造	1	534*380	0.28	45	○	○	○	○	○	○	○	45.0*45.0	13.0							16-12	Nexim		
NXT III c (H02F)(LTC付)		チップマウンター	富士機械製造	2	534*380	0.54	19	○							74.0*74.0(32.0*180.0)	25.4							16-12	Nexim	トレ部品搭載		
SNR-1050GT		リフロー	千住	1	500*500														○		済み		自動幅調/ソリ防止/他	16-12	KIC搭載	済み。実績あり	
YSi-V		3D半田外観検査装置	ヤマハ	1	610*560					○	○	○						○		済み			18-10		済み。実績あり		
P-SMT	P-SMT1	STS-5050IN	セレクトティブトレース半田装置	セイテック	2	500*500												○		済み			16-12	インライン	済み。実績あり		
		UNIX-700H	レーザー半田装置	ジャパソニクス	2	510*460												○		済み			16-12		済み。実績あり		
		MV-6eOMNI	3D半田外観検査装置	ミルテック	1	510*460				○	○	○							○		済み			16-12		済み。実績あり	
		1220-55	インサーキットテスター	日置	1	検査治具による																		16-12	自動検印仕様	済み。実績あり	
		γ-S330 IN LINE-HR(JHD)	ルーター分割機	オーロテック	1	510*460																		16-12	インライン	済み。実績あり	
			基板エアブローシステム	ヒムエレクトロ	1																			18-2		済み。実績あり	
		P-SMT2	STS-5050IN	セレクトティブトレース半田装置	セイテック	2	500*500													○		済み			16-12	インライン	済み。実績あり
			UNIX-700H	レーザー半田装置	ジャパソニクス	1	510*460													○		済み			16-12		済み。実績あり
			MV-6eOMNI	3D半田外観検査装置	ミルテック	1	510*460				○	○	○							○		済み			16-12		済み。実績あり
			1220-55	インサーキットテスター	日置	1	検査治具による																		16-12	自動検印仕様	済み。実績あり
	γ-S330 IN LINE-HR(JHD)		ルーター分割機	オーロテック	1	510*460																		16-12	インライン	済み。実績あり	
			基板エアブローシステム	ヒムエレクトロ	1																			18-2		済み。実績あり	
	P-SMT3	UNIX-700H	レーザー半田装置	ジャパソニクス	1	510*460													○		済み			16-12		済み。実績あり	
		MV-6eOMNI	3D半田外観検査装置	ミルテック	1	510*460				○	○	○							○		済み			16-12		済み。実績あり	
		1220-55	インサーキットテスター	日置	1	検査治具による																		16-12	自動検印仕様	済み。実績あり	
		γ-S330 IN LINE-HR(JHD)	ルーター分割機	オーロテック	1	510*460																		16-12	インライン	済み。実績あり	
			基板エアブローシステム	ヒムエレクトロ	1																			18-2		済み。実績あり	
	LCD	STS-2533F	セレクトティブトレース半田装置	セイテック	1	330*250													○		済み			08-06		済み。実績あり	
		MV-3L	半田外観検査装置	ミルテック	1	500*400																		16-12		済み。実績あり	
		共昌	STS-2533F	セレクトティブトレース半田装置	セイテック	1	330*250													○		済み			08-06		済み。実績あり
STS-2533SJ	セレクトティブトレース半田装置		セイテック	1	330*250													○		済み			10-09		済み。実績あり		
UJS-450	反転機構つき半田ロボット		ジャパソニクス	1	330*250													○		済み			05-09		済み。実績あり		
AOI	AOI	YSi-X	X線半田外観検査装置	ヤマハ	1	510*460				○	○	○											17-12		済み。実績あり		
汎用検査機	1240-61	フライングインサーキットテスター	日置	1	510*460																		18-01	インライン	済み。実績あり		
	1220-02	インサーキットテスター	日置	1	検査治具による																		16-11		済み。実績あり		
基板分割機	γ-S330 PRO(JHD)	ルーター分割機	オーロテック	1	510*460																	16-10		済み。実績あり			
組立て	LI	UNIX-414-A	コテ式半田ロボット	ジャパソニクス	1	300*275												○		済み			06-04		済み。実績あり		
		γ-S330 DT-II(JHD)	ルーター分割機	オーロテック	1	330*250																					
	TS	UNIX-DT-403L	レーザー半田装置	ジャパソニクス	2	400*365	</																				